

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☒ 现场访谈 ☐ 其他 ☐ 线上分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 线上调研
参与单位名称	特定对象调研、线上调研、现场访谈：中银基金、泰康资产、申万菱信基金、浦银基金、太平资产、前海开源基金、中泰证券、鑫元基金、长安基金、招商基金、汇丰晋信、诺安基金、华安基金、建信理财、博时基金、富国基金、新华基金、九泰基金、广东谢诺辰阳私募、摩根士丹利基金、创金合信基金、兴全基金、交银施罗德基金、中国人寿养老保险、华泰资管、非马投资、钦沐资产、富安达基金、泰信基金、易方达基金、上海常春藤私募、大成基金、天风证券、长城基金、平安养老保险、华宝基金、嘉实基金、泓德基金、兴业基金、华泰保兴基金、睿郡资产、东方阿尔法基金、西部利得基金、摩根资产管理、天弘基金、鹏华基金、上海煜德投资、中国人保资产管理、平安基金、玄元私募基金、广东正圆私募基金、江信基金、摩根基金、宁银理财、国泰基金、海富通基金、长盛基金、鸿运私募基金、湖南源乘私募、华福证券、亚太财产保险、金元顺安基金、上海金友创智私募基金、招银理财、长城财富投资、兴业证券、中再资产管理、中信建投资本、国泰海通证券、中信金融资产、上海润义投资管理、银河证券、中邮证券、财通资管、鹏扬基金、源峰基金、泰康基金、平安资产、泉果基金、农银基金、永赢基金、工银瑞信、南方基金、长信基金、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS、GIC PRIVATE LIMITED、GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT、GREENWOODS ASSET MANAGEMENT、INVESCO GLOBAL、PICTET ASSET MANAGEMENT、POLYMER CAPITAL

	MANAGEMENT、POINT72、SPRINGS CAPITAL、STONEYLAKES ASSET MANAGEMENT、德邦基金、中信保诚基金、浙商证券、财通基金、富荣基金、国寿养老、国金证券、国海证券、申万宏源证券、摩根大通证券、西部证券（以上排名不分先后）； 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者； 网上集体接待日活动：参与活动的投资者。
时间	2026 年 8 月 27 日至 2026 年 9 月 15 日
地点	公司会议室、腾讯会议、策略会现场、上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）、“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）。
上市公司接待人员姓名	特定对象调研、线上调研、现场访谈：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生； 业绩说明会：董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士； 网上集体接待日活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。 公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。 公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机

率)、可并行测试最大工位等指标已与同类产品的国际先进水平同步。

二、公司 2026 年上半年经营情况介绍

2026 年上半年,受 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的驱动,公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长,叠加公司全球化业务布局成效逐步显现,境外市场订单较上年同期实现较好增长。因此,2026 年上半年,公司产品测试分选机销量实现较大提升,公司业绩实现较好的增长。公司 2026 年上半年实现营业收入 6.01 亿元,较上年同期增长 95.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元,较上年同期增长 125.21%;2026 年上半年,公司实现剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 2.00 亿元,较上年同期增长 139.10%;截至 2026 年 6 月末,公司总资产为 26.38 亿元,较上年末增长 22.73%;截至 2026 年 6 月末,公司净资产为 18.97 亿元,较上年末增长 17.50%。

2026 年上半年,公司持续升级迭代三温测试分选机 EXCEED-9800 系列及大平台超多工位测试分选机 EXCEED-9032 系列以及适配特殊包装器件即非传统料盘(料管、振动盘等)上下料方式的芯片测试的 NEOCEED 系列等产品。同时,公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求,通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术,持续扩容公司动态演进的技术储备池。2026 年上半年,公司产品测试分选机新增高速 Gap scan(间隙扫描)检测、智能 CCTV 全机台监控、Digital twin 等功能,升级迭代 Tray scan(料盘扫描)功能至 2.0 版本。

公司持续加大市场推广力度,不断精进全球化市场服务能力,深化客户服务。2026 年上半年,公司积极拓展新增客户群体,持续深化既有客户合作关系,全面强化客户服务能力建设。

三、调研及业绩说明会问答

1、问:请问公司业绩高速增长主要受益于哪些下游应用领域的需求拉动?

答:2026 年上半年,受 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的驱动,公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长,公司产品测试分选机销量实现较大提升,公司业绩实现较好的增长。公司 2026 年上半年实现营业收入 6.01 亿元,较上年同期增长 95.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元,较上年同期增长

	125.21%。 2、问：公司目前的下游需求持续性如何，有哪些相关影响因素？ 答：公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。 在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025 年全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI 及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会（SIA）数据显示，2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元，较 2024 年同比增长 25.6%，创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。上述驱动因素动能的持续释放，将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。 特别是随着先进封装、AI 算力芯片等的发展，相关芯片测试的复杂度在攀升，芯片测试总耗时大幅提高，对高端测试资源的需求在快速增加；与此同时，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。 未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保产品质量、生产效率和生产稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求，测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。 3、目前客户下单的节奏大概是什么节奏（提前多久下单）？ 答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。 4、请问公司目前采用什么样的生产模式？ 答：公司产品具有较强的定制化属性，公司主要实行“以销定产”
--	--

和“安全库存”的生产模式，结合库存和市场情况安排生产计划，并采用核心产品自主生产、部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

5、问：参股布局产业链多家科创企业，如何衡量产业投资对主业的实际协同价值？

答：公司从技术协同、供应链联动、产业前瞻赋能等维度，综合衡量参股科创企业投资项目对主营业务的实际协同价值，综合、动态衡量产业投资对公司主营业务带来的实际协同价值。

6、问：核心零部件国产化替代推进，在性能、交付周期上存在哪些现实约束？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司生产所需主要原材料主要为国内供应商、代理商或贸易商提供，其中部分涉及进口品牌，但主要生产地在中国大陆。同时，上述原材料能找到提供同类产品的国产厂商进行替代。

7、问：HBM、先进封装对应的分选需求提升，现有平台改造还需要补齐（持续迭代升级）哪些能力？

答：随着先进封装的发展，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。公司持续迭代测试分选机的温控精度、热管理效率、多工位并行测试及动态适配等方面的能力，进一步创新和发展来满足更多类型的测试分选需求。

8、问：马来西亚基地扩产，海外订单放量，如何管控稼动率与汇兑带来的扰动？

答：公司对马来西亚生产运营中心实施产能与订单动态匹配管理，平滑稼动率波动；建立汇率风险防控体系，保障海外基地经营稳健运行。

9、问：请问上半年境外收入占比达到多少？

答：2026年上半年，公司境外收入占比约为28%。

10、问：上海澜博制造中心建设，新产能爬坡阶段，供应链与人员储备面临哪些挑战？

答：上海澜博半导体设备制造中心建设项目，以复用公司现有成熟供应链体系为主，供应链无需作出重大调整；新基地物料流转磨合、技能人员培育属于投产过程中客观存在的挑战。公司已制定人员储备

	及厂区供应链适配方案，项目各项筹备及实施工作有序推进。 11、问：国内同行入局分选赛道，行业价格竞争加剧，如何维护高端机型毛利率水平？ 答：公司自设立以来，一直致力于为全球集成电路行业提供国际先进水平的集成电路测试分选机。通过持续的自主研发及长期的技术积淀和工艺传承，公司持续对产品进行迭代升级和拓展，凭借公司在集成电路测试分选领域的长期积累和口碑，公司持续深度服务客户，构建常态化技术协同网络与市场需求敏捷响应机制，以持续迭代的产品与服务体系赋能客户价值增长。
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 9 月 15 日